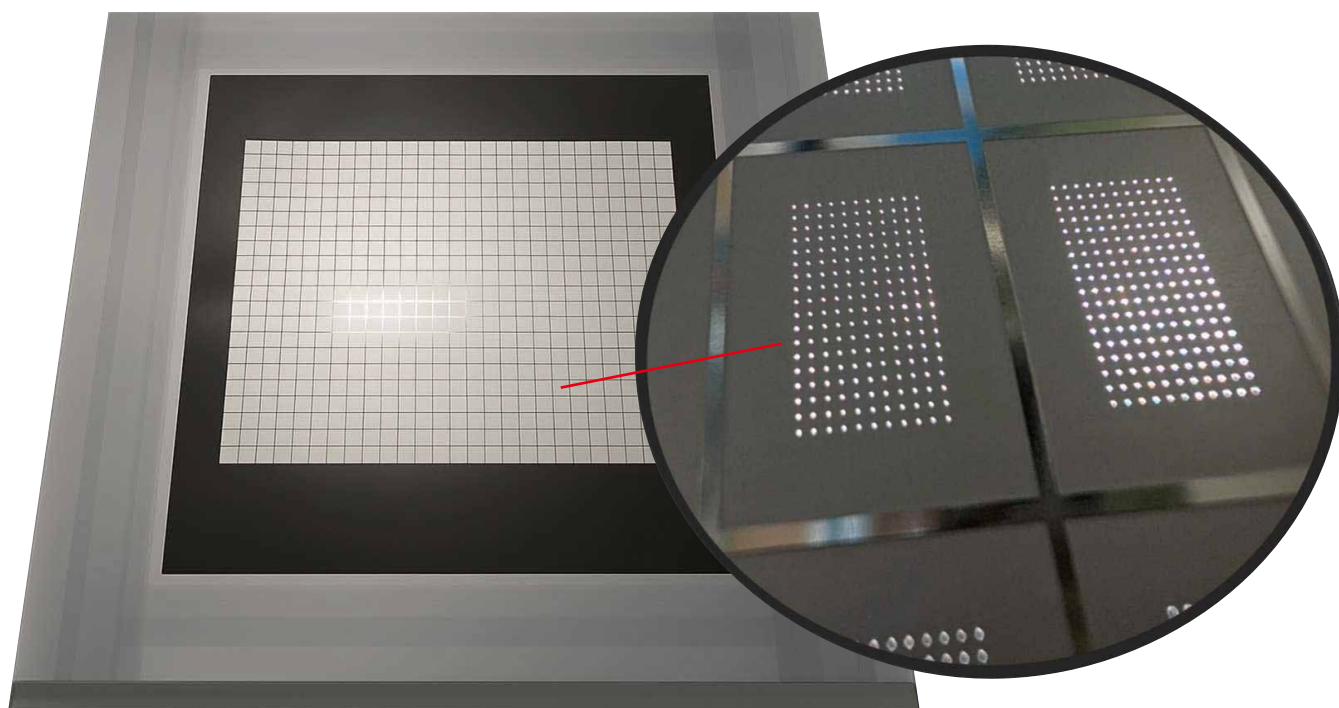


半導体パッケージ基板 ボール搭載用 レーザー加工 メタルマスク



レーザー加工技術の特徴



板厚精度が良い！ 積層工程なしで

均一な厚み



短納期対応可能！ シンプル工程だから

最短翌日発送

※パターン数により変動



ローコスト実現！ シンプル工程だから

低価格

比較表

比較項目		アディティブ加工	レーザー加工
QCD	品質	◎	○
	納期	△	○
	価格	○	◎
開口数	多	◎	△
	少	△	◎